

公司代码：688107

公司简称：安路科技

**上海安路信息科技股份有限公司**  
**2025 年年度报告摘要**



## 第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2、重大风险提示

报告期内，尽管诸多下游应用领域去库存周期已近尾声，但由于部分终端行业客户需求阶段性波动，全年营业收入较上年同期有所减少。同时为了进一步加强及巩固自身核心竞争力，丰富公司产品系列以覆盖更多的下游应用领域，报告期内研发投入仍然保持在较高水平，使得报告期内归属于母公司所有者的净利润仍为负值。公司核心竞争力、持续经营能力未发生重大变化。由于公司目前依然保持较大的研发投入，未来若出现下游市场需求复苏缓慢、行业竞争加剧、新产品在客户端导入放量不及预期等情形，公司可能面临继续亏损的风险。

公司已在本报告中描述了可能存在的风险，详细内容敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-272,449,975.33元，母公司实现净利润为人民币-235,090,581.14元。截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为人民币-624,124,044.45元。

结合公司现阶段的经营业绩情况，综合考虑公司生产经营需要，为保证公司未来的可持续发展及全体股东的长期利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

截至报告期末，公司母公司财务报表中存在累计未弥补亏损人民币-624,124,044.45元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《上海安路信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司目前尚不满足实施现金分红的前提条件。公司未来将继续做好经营管理，改善经营业绩，以期更好地回报投资者。

## 8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1、 公司简介

#### 1.1 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	安路科技	688107	不适用

#### 1.2 公司存托凭证简况

适用 不适用

#### 1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴浩然	姚琰
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区中科路1867号C座11-12层	中国（上海）自由贸易试验区中科路1867号C座11-12层
电话	021-61633787	021-61633787
传真	021-61633783	021-61633783
电子信箱	Public@anlogic.com	Public@anlogic.com

## 2、 报告期公司主要业务简介

### 2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司自设立以来，始终专注于FPGA、FPSoC芯片及FPGA专用EDA软件的研发设计与技术创新，构建并持续完善“FPGA/FPSoC芯片+专用EDA软件+IP/System解决方案+全周期技术支持”的一站式服务体系，为客户提供端到端的技术保障。凭借差异化布局的产品矩阵、经大规模验证的产品质量、高效的技术支持、自主可控的知识产权等优势，公司产品已广泛应用于通信、工业、数据中心、医疗、汽车电子、电力与新能源、音视频广播、消费电子等领域，成为了国内领先的FPGA产品供应商，在多个细分场景占据国产FPGA芯片主导地位。



按照产品硬件架构类型划分，公司产品类型分为FPGA芯片和FPSoC芯片。其中，FPGA芯片主要包括SALPHOENIX高性能产品系列、SALEAGLE高效率产品系列、SALELF低功耗产品系列（以下简称



PHOENIX、EAGLE、ELF)等,在逻辑规模、工艺节点、功能性能、封装类型、可靠性要求等方面形成了较为齐全的产品布局,适配网络通信、工业自动化、汽车电子、智算中心服务器、视频处理、智能电网、新能源等广泛领域的众多场景,以及不断发展的新兴场景;FPSoC芯片主要包括SALSWIFT低功耗产品系列、SALDRAGON高性能产品系列(以下简称SWIFT、DRAGON)等,通过在单芯片架构中高度集成可编程逻辑(FPGA)、嵌入式处理器(CPU)硬核及高速接口、片上存储器等关键IP核,兼具硬件架构的可编程灵活性、系统级集成的高可靠性与小型化优势,可满足工业控制、汽车电子、消费电子、视听广播等领域对异构算力与复杂应用适配的核心需求。

在软件工具方面,公司自主研发了支持全系列芯片应用的专用EDA软件TangDynasty、FutureDynasty,为客户提供全流程的集成开发环境。其中,TangDynasty主要用于FPGA的客户个性化功能实现,具备高效的综合优化引擎与丰富的分析调试工具,助力开发者高效完成设计开发;FutureDynasty专为FPSoC芯片打造,支持ARM、RISC-V两种主控CPU架构和多种实时操作系统,助力用户高效、敏捷地完成系统功能的开发与部署。

在生态建设方面,公司秉持开放合作理念,持续完善开发者支持体系,并围绕核心应用场景研发了丰富的应用IP及参考设计。目前,公司已推出工业核心板、ISP图像处理、NPU加速处理等超过200个应用IP及参考设计,覆盖以太网、信号处理、工业、音视频显示、通用接口、微控制器、外围总线等12个应用分类,有效降低了客户开发门槛,缩短产品研发周期,加速产品上市进程。

公司五大产品系列PHOENIX、EAGLE、ELF、DRAGON、SWIFT,以及支持以上产品的全流程FPGA专用EDA软件工具链TangDynasty软件和FutureDynasty软件,具体情况及主要特点如下:

产品类型	系列名称	产品介绍	应用领域	产品图片
FPGA	ELF	ELF系列FPGA定位低功耗可编程市场,包括4个产品家族的丰富产品型号,具有无需外部配置器件、低密度逻辑容量、高用户IO数量、存储资源丰富等特性,IO接口支持1Gbps速率,最高用户IO数量475个,部分规格型号通过车规AEC-Q100标准测试,适用于功能扩展、高速接口扩展与转换、高速总线扩展、高速存储器控制等丰富场景。	通信、工业、汽车电子、数据中心、视听广播、电力与新能源、测试测量等	
	EAGLE	EAGLE系列定位高性价比逻辑控制和图像处理市场,具有数量适中的逻辑和乘法器,丰富多样的片内存储器,高达1Gbps的IO速率,使得EAGLE器件非常适合于图像预处理,运控与伺服和高速图像接口转换等领域。	工业、通信、数据中心服务器等	

	PHOENIX	PHOENIX系列FPGA定位高性能可编程逻辑市场，产品架构具有灵活的可扩展性，支持多层级逻辑规模、高速运算单元、丰富的存储资源、DDR3/4以及SerDes等高性能接口，部分规格产品集成RISC-V硬核处理器，可以提供良好的信号处理和数据传输功能，满足工业、通信、数据中心与计算等市场需求。PHOENIX系列包括3个产品家族，提供覆盖较大逻辑单元规模范围、多个工艺平台的丰富产品型号，部分产品通过车规AEC-Q100标准测试。	工业、通信、医疗、音视广播、数据中心与计算、汽车电子、测试测量与仿真验证等	
FPSoC	SWIFT	SWIFT家族定位高带宽的视频数据处理和桥接可编程系统级芯片市场，产品集成了FPGA逻辑单元、存储单元、视频处理单元、RISC-V处理器核等资源以实现专用领域的系统级功能，在保持低功耗的前提下，提供高达17.6Gbps带宽的MIPI数据收发能力。	消费电子、工业等	
	DRAGON	DRAGON家族定位复杂嵌入式系统、低功耗和高性能芯片市场，产品集成FPGA可编程逻辑单元阵列、硬核处理器系统、运算加速引擎，产品集成单核64位RISC-V或双核ARMCortex-A35等高性能硬核处理器，具有专属MIPI高速视频接口、DDR3\DDR4高速存储接口，支持千兆以太网，配套公司自主开发的嵌入式软件SDK、集成开发环境工具，能够满足工业等应用领域对计算能力、可扩展性、实时性、稳定性等方面的高要求。	工业、汽车电子、音视广播、电力与新能源、边缘计算等	
软件	TangDynasty	TangDynasty (TD) 软件是公司自主开发的FPGA集成开发环境，支持工业界标准的设计输入，包含完整的电路优化流程以及丰富的分析与调试工具，并提供良好的第三方设计验证工具接口，为所有基于公司FPGA产品的应用设计提供有力支持。该软件针对每个系列芯片特性进行针对性开发、算法升级和迭代，并持续革新核心算法与流程。	FPGA 专用 EDA 软件	
	FutureDynasty	FutureDynasty (FD) 软件是面向ARM和RISC-V架构的嵌入式软件集成开发环境，兼容多种编译器与调试器，适配公司FPSoC芯片并支持多种主流操作系统。FD软件具有代码编辑、编译、下载、调试等功能，支持丰富的插件和模板，并内置烧写	FPSoC 专用软件	

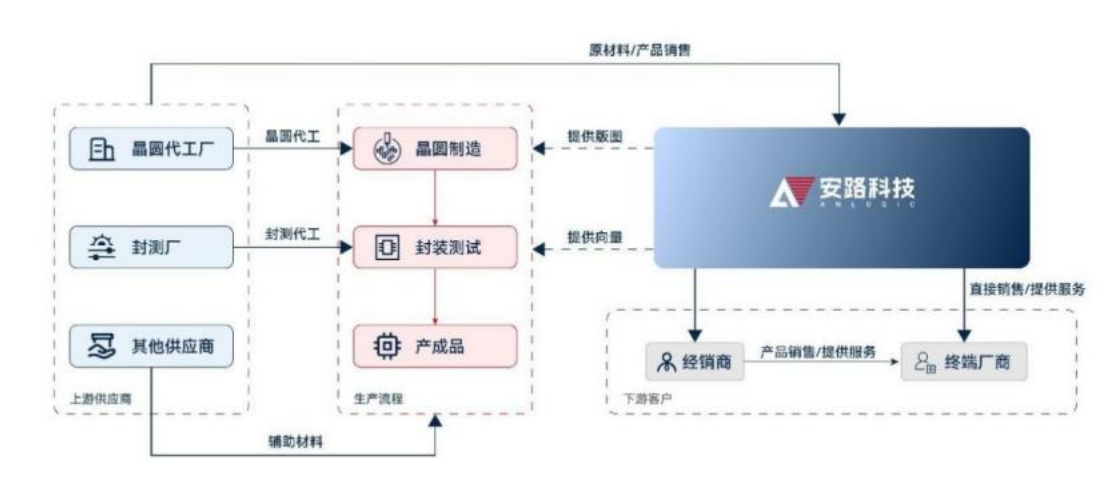
		Flash等多种实用工具。用户可根据FD提供的模板，无须配置项目参数，快速创建相应工程，实现ARM、RISC-V工程编译与调试。		
--	--	--	--	--

## 2.2 主要经营模式

公司采用业内典型的Fabless经营模式，专注于集成电路芯片的设计、研发和销售，对于集成电路的生产制造、封装及测试等其他环节采用第三方晶圆制造和封装测试企业代工的方式完成。

在FPGA芯片研发完成后，将研发成果即集成电路产品设计版图交付给专业的晶圆代工厂进行晶圆制造，再交由封测厂进行封装测试，最终将FPGA芯片直接或通过经销商销售给下游终端厂商。由于FPGA芯片需先进行编程后使用的特殊性，公司还针对不同行业研发模块化应用IP或设计参考方案，以便终端客户直接调用IP模块或者基于参考方案开发自己的设计，从而加快客户产品开发速度，充分发挥公司软硬件产品的性能。此外，为了提高测试效率，降低测试成本以及获得更完整的测试结果，公司自主研发了一系列测试方法，根据这些测试方法开发测试向量，并在测试厂使用公司开发的专用测试向量对公司芯片进行量产测试。

公司的整体经营模式如下图所示：



## 2.3 所处行业情况

### (1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事集成电路产品的研发设计与销售，根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》《国民经济行业分类目录》（GB/T4754-2017），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39”。

#### (1) 行业发展情况

2025年，人工智能相关应用快速发展并加速向更广泛行业渗透，计算与数据中心基础设施投入持续扩大，汽车电动化智能化及工业自动化深度推进，共同驱动半导体产业实现强劲增长。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2025年全球半导体销售额将跃升至7,720亿美元，同

比增长 22%；预计 2026 年所有地区和产品品类均有望实现增长，市场规模将达到 9,750 亿美元，同比增加 25%。在此背景下，国内半导体产业正处于全球复苏共振、创新应用爆发、国产替代提速的三重机遇期，增长动力由传统消费电子转向AI算力基础设施与智能终端双向赋能，“全球+本土”的双轴韧性正成为保障企业长期生存、获得战略订单和避免巨额断供损失的必要投资，为国产芯片企业的结构性替代与差异化发展奠定了坚实基础。

FPGA凭借其高并行计算能力、低延迟特性及灵活可重构的架构优势，在多传感器实时数据处理、设备间高效无缝连接、硬件加速与协处理、算法模型快速迭代优化、高可靠性与冗余设计等众多关键场景中发挥着重要作用，有效契合了当前产业对算力效率、灵活性和确定性响应的迫切需求。2025 年，FPGA行业逐步走出周期性调整低谷，迎来由结构性需求驱动的复苏。受 5G建设趋于成熟的影响，传统通信市场对FPGA的增量贡献逐渐放缓，但AI服务器升级、数据中心建设加速、汽车智能化转型等新需求，正为FPGA行业打开全新增长空间。同时，伴随着下一代通信技术试点、智能端侧规模化落地、新兴场景持续拓展，FPGA行业有望进入高速增长期。在全球供应链重塑与国产替代提速的浪潮下，国产FPGA份额稳步提升。据Markets and Markets预测，2030 年全球FPGA市场规模有望达到约 193.40 亿美元，2025 年至 2030 年的复合年增长率达到 10.50%，其中亚太地区为全球最快增长区域。

## (2) 行业主要特点

FPGA芯片属于逻辑芯片大类，是架构灵活的可编程芯片，兼具高并行性和低时延性。FPGA凭借其独特优势，应用边界不断拓宽，主要呈现以下特点：

### 1) FPGA芯片具有高度灵活性，下游应用领域丰富

FPGA芯片的最大特点是现场可编程性。无论是CPU、GPU、DSP、Memory还是各类ASIC芯片，在芯片被制造完成之后，其功能就已被固定，用户无法对其硬件功能进行任何修改。而FPGA芯片在制造完成后，没有具体电路功能，用户可以根据实际需要，将其电路功能描述通过FPGA芯片公司提供的FPGA专用EDA软件编译生成二进制位流，现场将二进制位流下载到FPGA芯片进行功能配置，从而将空白的FPGA芯片转化为具有特定功能的集成电路芯片。每颗FPGA芯片均可以进行多次不同功能配置，从而实现不同的功能，具有高度灵活性。

通过对FPGA进行编程，用户可以随时改变芯片内部的连接结构，实现需要的逻辑功能，尤其适用于多协议接口灵活配置场景，可兼容不同通信协议及外部设备接口，快速适配多样化硬件环境。在技术标准、协议、算法等尚未成熟，或者发展更迭速度快的行业领域，FPGA能有效帮助企业降低投资风险及沉没成本，是一种兼具功能性和经济效益的选择。此外，FPGA还可在不同的业务需求之间灵活调配，如在不同时段实现不同功能，以放大经济效益，提升设备利用率。凭借这一优势，FPGA芯片具备了极强的通用性与场景适配能力。在自动化、网联化、数字化、智能化深度融合的驱动下，汽车电子、数据中心与计算、工业设备、低空经济、机器人、电力与新能源、医疗影像、消费电子等领域的转型升级需求旺盛，推动FPGA应用范围与渗透深度持续提升。

### 2) FPGA芯片的独特架构可以适应要求低时延和大量并行计算的场景

FPGA是典型的硬件逻辑，其内部由海量可编程逻辑单元、数字信号处理单元、存储单元及高

速互联等资源构成。在芯片配置（烧写/重编程）阶段，每个逻辑单元与周围逻辑单元的连接构造在重编程（烧写）时就已经确定，寄存器和片上内存属于各自的控制逻辑，无需通过指令译码、共享内存来通信。FPGA内部的大量可编程逻辑单元模块可以同时独立工作，实现大规模并行计算的耗时极短，大幅提升数据处理效率。

同时，由于FPGA采用硬件电路级的执行方式，不存在软件系统中常见的线程抢占、资源竞争、调度延迟等问题，具备确定性低时延的突出优势，时延波动极小、响应稳定可控。这一特性使FPGA能够精准适配对实时性、可靠性要求严苛的应用场景，尤其在智能制造的高精度运动控制、医疗设备的高速信号采集与处理、智能驾驶的多传感器融合与实时决策等领域，均可发挥独特的优势作用。

### 3) FPGA芯片可以实现高集成性，满足下游市场多样化需求

FPGA可以根据下游市场的差异化需求，在芯片内部嵌入丰富硬核IP或软核IP，形成面向不同应用场景的FPSoC芯片产品矩阵，高效满足用户多样化、定制化的系统级需求。FPSoC芯片以单芯片高度集成CPU、FPGA、专用数据处理引擎、高速存储接口与高速传输接口等模块，将软件灵活编程、硬件可重构配置、硬件并行运算等功能整合到单芯片中，具备芯片面积更小、整体成本更优、片内信号传输时延更低、数据交互更安全可靠等显著优势。

凭借高集成度、高灵活性与高可靠性等特点，FPSoC芯片的应用场景持续拓宽，已广泛覆盖工业自动化、汽车电子、数据中心加速、边缘计算、医疗设备、测试测量、高清视频处理、物联网终端等多个领域，能够充分满足应用场景对实时控制、算力加速、功能安全与系统小型化的旺盛需求。作为FPGA行业技术迭代与产品升级的重要方向，FPSoC技术路线受到国内外主流FPGA企业的高度重视与持续投入，具有广阔的市场前景。

### (3) 主要技术门槛

集成电路设计属于技术密集型行业，涉及学科众多，需要复杂先进而又尖端的科学技术支撑其发展。主流集成电路设计企业大多具备优秀的研发能力，掌握所从事领域核心技术，产品和技术经过多次更新迭代，才能在行业内的激烈竞争中脱颖而出，拥有立足之地。

FPGA行业技术门槛主要体现在芯片硬件设计、FPGA专用EDA软件开发、全流程产品工程设计三个方面。

#### 1) 芯片硬件设计

FPGA芯片独有的现场可编程特性和并行阵列结构，要求研发工程师在拥有很高的硬件专业知识的同时，理解软件开发和硬件加速的要求，而FPSoC芯片研发更是需要掌握SoC和FPGA协同设计的系统级芯片开发技术。因此，FPGA和FPSoC芯片技术开发难度大，往往新产品研发周期较长，产品定位必须平衡市场上多个应用需求，并对行业发展有深刻理解，才能及时推出满足市场需求、有竞争力的产品，对FPGA厂商技术水平、市场洞察能力等要求较高。

#### 2) FPGA专用EDA软件开发

FPGA的软件系统是FPGA专用EDA软件的一个分类，包括逻辑综合、物理优化、布局布线等技术难题，涉及大量的数学建模、优化求解、算法设计，是集成电路领域最尖端的技术之一。FPGA的规模与性能每上一个台阶，就必须更新配套的映射、包装、布局布线等算法。这种硬件和软件高度绑定的特点，使得FPGA新进厂商在攻克了硬件的诸多技术难点外，还要完成配套软件和复杂工具包的开发。对于一家FPGA芯片公司来说，研发出高品质的FPGA软件系统的难度不亚于研发出一颗高性能FPGA芯片。

### 3) 全流程产品工程设计

FPGA芯片大量应用在对可靠性要求较高的领域，其通用性强、支持协议众多、功能复杂、规模大、性能高等特点，对从立项到研发到最终量产管理的全流程产品工程提出了较高要求。FPGA厂商需要从长期的产品研发与量产管理过程中，基于大量工艺平台数据、产品测试验证数据、研发及应用经验等，持续完善产品开发技术、标准、流程、工具、方法等，以便提供高品质、成本优化的FPGA芯片及服务，在市场中站稳脚跟。

综上所述，行业内的新进入者往往需要经历较长一段时间的技术摸索和经验积累，才能和行业内已经占据技术优势的企业抗衡，因此FPGA行业技术门槛较高。

## (2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内较早开始FPGA、FPSoC芯片及专用EDA软件研发、设计和销售的企业，已成为国内FPGA行业的领军企业。经过多年深耕，公司积淀了深厚的技术实力，掌握了FPGA硬件设计技术、FPGA专用EDA软件设计技术、芯片测试技术、应用技术等FPGA全套核心技术；不断推出具有市场竞争力的创新产品，丰富FPGA和FPSoC芯片产品矩阵，形成了覆盖主流核心场景需求的产品布局；凭借优质的产品与专业的服务，累计服务客户超两千家，涵盖通信、工业、医疗、汽车电子、数据中心、电力与新能源等众多领域的头部企业，业内市场认可度与品牌美誉度持续攀升。凭借自身科研和产业化能力，公司获得了国家级专精特新“小巨人”、国家级博士后科研工作站、高新技术企业、上海市科技进步奖二等奖、中国电子学会科技进步奖二等奖、首批上海市创新型企业总部、上海市企业技术中心、上海市民营企业总部、上海市重点产品质量攻关成果一等奖、虹口区区长质量奖金奖等荣誉资质。

报告期内，公司持续巩固行业领先地位，扩大竞争优势。市场拓展方面，公司在巩固网络通信、工业控制等传统市场基础的同时，不断突破数据中心服务器、电力与新能源、汽车电子、医疗设备、机器人、视频处理等行业关键头部客户，新兴领域重点客户、新产品导入项目数显著增加，客户覆盖广度和合作深度大幅提升；技术研发方面，公司在先进制程、高性能通用IP、车规产品、FPGA专用EDA软件工具链等关键技术方面取得了一系列重要突破，进一步提升产品在指标先进性、用户开发效率、质量与可靠性、供应链稳定性等方面的表现，助力客户更好地契合技术与应用发展趋势；品牌建设方面，公司通过举办技术沙龙、参与行业展会、深化产学研合作等多元化举措，持续扩大品牌影响力，不断提升行业话语权，成为推动国内FPGA行业高质量发展的重要力量。

### (3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

FPGA行业经过四十余年的发展，在半导体制造工艺及电子信息技术不断演进、下游应用领域技术需求和应用场景持续迭代的助力下，已经从简单的逻辑控制芯片发展成高度复杂的系统级运算和控制芯片，逻辑阵列容量、性能、集成度、功耗、软件易用性等方面快速提升，应用领域越来越丰富，主要呈现以下发展趋势。

#### (1) 最高端FPGA芯片向先进制程、先进封装方向发展

随着人工智能、物联网、新一代无线通信和自动驾驶等技术的不断演进，全球产业正经历颠覆性变革，对硬件信息处理能力的要求不断提高。为了满足业界对超大规模与超高性能FPGA持续提高的需求，主流厂商推出的FPGA芯片产品逻辑阵列容量和系统性能不断增长。但受制于生产工艺特点和芯片物理特性，芯片单DIE面积越大其良率也就越低，因此，FPGA龙头企业采用Chiplet技术将多个裸片封装成一颗芯片以提供更高密度的FPGA产品。先进制程和Chiplet封装将是未来FPGA制造产业链发展的长期趋势。

#### (2) 向更丰富集成和高速互联方向发展

在信息技术快速迭代的推动下，FPGA芯片上集成越来越多的硬核IP模块，成为使FPGA功能进一步增强并且进入新应用场景的重要技术路径。国际主流FPGA芯片公司形成了在FPGA芯片中加入处理器CPU、图形处理器GPU、专用运算单元、多种高速接口等硬核的技术路线，可同时满足下游场景对运算效率与功能灵活性的双重需求。与此同时，支持芯片的软件系统也从硬件设计自动化流程扩展到高层次的系统级设计自动化流程，接受用户直接输入高级的人工智能算法或者高层次的系统级功能描述，软件根据芯片上的FPGA、CPU、DSP、Memory、专用运算单元等功能模块资源，自动优化芯片资源分配，进行软件和硬件的协同设计，实现用户期望的复杂系统功能。这种新型的现场可编程系统级芯片已经被大量应用在消费电子、工业、通信、汽车电子、电力与新能源等领域。随着FPGA、CPU以及其他芯片颗粒之间的集成规模与性能不断提高，高速的片间互联和强大的系统级软件正会成为关键技术。

#### (3) 向更高功能与性能方向发展

随着通信技术、数据传输协议、存储类型等不断迭代，终端应用的信息互联和数据交互需求快速提升，根据市场动态和客户需求推出高性价比产品变得尤为重要。因此，FPGA厂商纷纷针对各下游市场应用场景进行细分，推出了对应不同领域需求的高中低端产品系列，不断丰富量产工艺平台的产品布局，实现精准化市场覆盖。AMD(Xilinx)公司将2010年设计的部分28nm工艺FPGA芯片产品，在不增加逻辑容量的情况下，针对当前市场新需求进行了功能升级；最新一代产品集成PCIe GEN5/6、DDR5/LPDDR5、CXL3.1、GTM2收发器等高性能IP，增加对新兴应用场景的覆盖。Lattice公司在28nm工艺、16nm工艺节点推出了多个产品系列，支持MIPI、SerDes、DDR、USB3等丰富接口。因此，在重点工艺平台上持续完善产品矩阵是FPGA行业的发展趋势之一。

#### (4) 向适应快速发展的新兴应用领域需求发展

FPGA 芯片具有高度灵活、可扩展、并行计算等优势，可以较低成本实现算法的快速迭代，高效实现新场景的运算、控制和升级功能，具备广泛的通用性与场景适配性，是支撑新兴应用领域发展的核心器件。边缘计算、汽车电子、低空经济、数据中心、新一代信息技术、高端装备、民用航空、元宇宙、机器人、未来显示、新型储能等新兴领域快速崛起，新场景、新算法、新标准不断涌现，FPGA 芯片成为支持这些新场景应用的优先选择。在边缘计算领域，FPGA 可以实现支持 AI 模型在终端设备的高效推理、动态调整硬件架构适配不同算法、实时处理多传感器融合数据等功能，国外主流厂商纷纷发布新产品以满足不同边缘计算场景需求；在汽车电子领域，FPGA 芯片为快速增长的各种汽车电子应用需求提供了灵活的低成本高性能解决方案，包括多屏异构显示控制、智能交互处理、传感器融合计算、决策算法加速等场景；在数据中心领域，FPGA 能够使数据中心的不同器件更加有效地协同，最大程度发挥每个器件的硬件优势避免数据转换导致的算力空耗，提升云服务的响应速度和能效。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	1,131,680,188.79	1,388,329,739.30	-18.49	1,629,923,683.58
归属于上市公司股东的净资产	943,515,066.16	1,215,532,127.10	-22.38	1,445,266,110.49
营业收入	519,996,525.11	651,816,946.01	-20.22	700,785,890.76
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	510,800,881.42	647,171,795.37	-21.07	699,548,781.50
利润总额	-272,449,975.33	-205,141,813.17	不适用	-197,187,674.35
归属于上市公司股东的净利润	-272,449,975.33	-205,141,813.17	不适用	-197,187,674.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-304,499,768.01	-240,485,048.98	不适用	-226,667,841.91
经营活动产生的现金流量净额	-128,585,870.11	-61,935,321.58	不适用	-193,347,034.25
加权平均净资产收益率(%)	-25.24	-15.42	减少9.82个百分点	-12.93
基本每股收益(元/股)	-0.6797	-0.5118	不适用	-0.4924
稀释每股收益	-0.6797	-0.5118	不适用	-0.4924

(元/股)				
研发投入占营业收入的比例 (%)	66.33	55.77	增加10.56个百分点	54.82

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	93,294,153.40	130,048,338.89	144,898,307.76	151,755,725.06
归属于上市公司股东的净利润	-60,396,918.80	-81,994,347.13	-48,842,847.41	-81,215,861.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-72,099,079.48	-96,302,945.50	-50,966,466.96	-85,131,276.07
经营活动产生的现金流量净额	-16,296,826.64	-46,536,539.44	-28,050,547.34	-37,701,956.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4、 股东情况

### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,317					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,651					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0					
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0					
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条	质押、标记或冻结情况	股东性质

				件股份 数量	股份 状态	数量	
华大半导体有限公司	0	116,691,243	29.11	0	无	0	国有法人
上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)	-7,305,434	75,974,812	18.95	0	无	0	其他
深圳市信科基金管理合伙企业(有限合伙)－深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业(有限合伙)	-1,157,000	25,000,972	6.24	0	无	0	其他
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	-4,152,391	22,954,539	5.73	0	无	0	国有法人
上海科技创业投资有限公司	0	20,248,939	5.05	0	无	0	国有法人
杭州士兰创业投资有限公司	0	9,627,183	2.40	0	无	0	境内非国有法人
杭州士兰微电子股份有限公司	-1,893,824	8,300,000	2.07	0	无	0	境内非国有法人
深圳创维创业投资有限公司	-309,300	7,139,255	1.78	0	无	0	境内非国有法人
上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)	-415,378	4,319,849	1.08	0	无	0	其他
上海安路芯半导体技术合伙企业(有限合伙)	-296,174	3,080,138	0.77	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)、上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)与上海安路芯半导体技术合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为上海导贤半导体有限公司;杭州士兰微电子股份有限公司与杭州士兰创业投资有限公司存在关联关系;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

**存托凭证持有人情况**

适用 不适用

**截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

适用 不适用

**4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

**4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

**4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况**

适用 不适用

**5、公司债券情况**

适用 不适用

### **第三节 重要事项**

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体参见本节“二、经营情况讨论与分析”的相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用